

概要

※日本では販売していない製品の情報も含まれます。

P Z6 G4 Workstation



正面図

1. フロントハンドル
2. フロントI/Oモジュールオプション
 - プレミアム（オプション、上記写真に表示）：電源ボタン、USB 3.1 G1 Type-A × 2、USB 3.1 G2 Type-C × 2（左端のType Aポートは充電機能付き）、ヘッドセット/マイク、メディアカードスロット（オプション）。
 - スタンダード：電源ボタン、USB 3.1 G1 Type-A × 4（左端のType Aポートは充電機能付き）、ヘッドセット/マイク、メディアカードスロット（オプション）。
3. 5.25インチ外付けベイ × 2
4. スリムODDベイ × 1

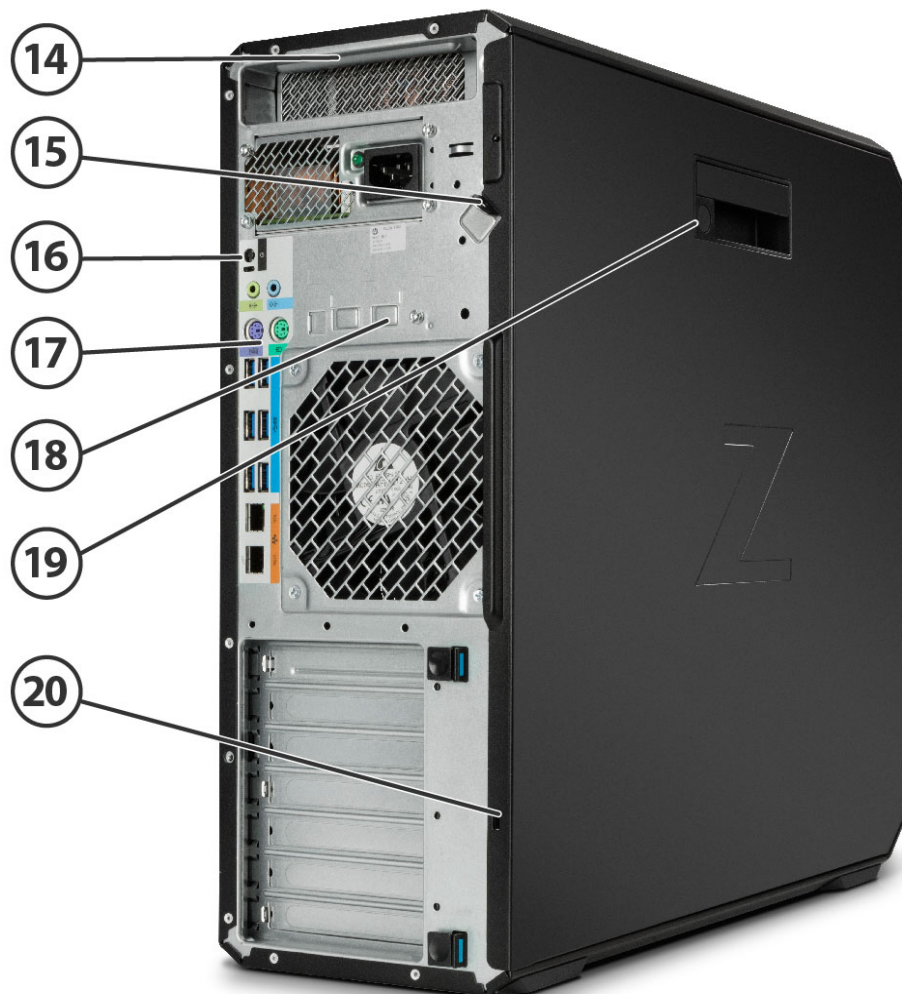
概要



内部図

- | | |
|--|--------------------------------|
| 5. 電源装置 : 1000 W 90%効率 (グラフィックス電源アダプター × 2装備) | 10. 6Gb/s SATAポート × 6 |
| 6. DIMMスロット × 6 : DDR4-2666レジスタ付きRAM | 11. SSD用のPCIe G3 x4 M.2 × 2 |
| 7. インテル® Xeon®プロセッサ スケーラブルファミリー | 12. 2.5インチ/3.5インチ内蔵ドライブ ベイ × 2 |
| 8. 2nd CPUおよびメモリ ライザー コネクタ :
2nd CPUソケットおよびDIMMスロット (× 6) を追加 | 13. 5.25インチ外付けドライブ ベイ × 2 |
| 9. PCIeスロット : PCIe G3 x16 × 2、PCIe G3 x4 × 3、PCIe G3 x8 × 1 | |

概要



背面図

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 14. | リアハンドル | 18. | HPデュアルポート10GbBase-T NICモジュール スロット (オプション) |
| 15. | 施錠用ループ | 19. | 側面パネルバレルキーロック (オプション) |
| 16. | リア電源ボタン | 20. | ケンジントンロック スロット |
| 17. | リアI/O (上から下) :
オーディオ入出力、キーボード/マウスPS/2、
USB 3.1 G1 Type-A × 6、1GbE LANポート × 2 | | |

概要

概要

フォームファクター 縦置き時
オペレーティングシステム プリインストール:

- Windows 10 Pro 64 for Workstations
- Linuxに対応（お客様のOSインストールのためにFreeDOS適用）
- Red Hat® Enterprise Linux® Desktopワークステーション（1年サポート付きの使用許諾契約書。プリインストールOSなし）

サポート対象:

- Windows 7 Professional 64ビット
- Red Hat Enterprise Linux Desktop 7.4
- SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP3
- Ubuntu 16.04 LTS

注: Linux®の詳しいOS/ハードウェアサポート情報については、次を参照してください：
http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix（英語サイト）

使用可能なプロセッサ

名前	コア	クロック速度 (GHz)	キャッシュ (MB)	メモリ速度 (MT/s)	ハイパースレッディング	インテル®vPro・テクノロジー搭載	インテル®ターボブーストテクノロジー ¹	TDP (W)
インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサ	28	2.5	38.50	2666	あり	あり	3.2、3.8	205
インテル® Xeon® Platinum 8160 プロセッサ	24	2.1	33.00	2666	あり	あり	2.8、3.7	150
インテル® Xeon® Gold 6152 プロセッサ	22	2.1	30.25	2666	あり	あり	2.8、3.7	140
インテル® Xeon® Gold 6154 プロセッサ	18	3.0	24.75	2666	あり	あり	3.7、3.7	200
インテル® Xeon® Gold 6148 プロセッサ	20	2.4	27.50	2666	あり	あり	3.1、3.7	150
インテル® Xeon® Gold 6142 プロセッサ	16	2.6	22.00	2666	あり	あり	3.3、3.7	150
インテル® Xeon® Gold 6136 プロセッサ	12	3.0	24.75	2666	あり	あり	3.6、3.7	150
インテル® Xeon® Gold 6140 プロセッサ	18	2.3	24.75	2666	あり	あり	3.0、3.7	140
インテル® Xeon® Gold 6134 プロセッサ	8	3.2	24.75	2666	あり	あり	3.7、3.7	130
インテル® Xeon® Gold 6132 プロセッサ	14	2.6	19.25	2666	あり	あり	3.3、3.7	140
インテル® Xeon® Gold 6130 プロセッサ	16	2.1	22.00	2666	あり	あり	2.8、3.7	125
インテル® Xeon® Gold 6128 プロセッサ	6	3.4	19.25	2666	あり	あり	3.7、3.7	115
インテル® Xeon® Gold 5120 プロセッサ	14	2.2	19.25	2400	あり	あり	2.6、3.2	105
インテル® Xeon® Gold 5118 プロセッサ	12	2.3	16.50	2400	あり	あり	2.7、3.2	105
インテル® Xeon® Gold 5122 プロセッサ	4	3.6	16.50	2666	あり	あり	3.7、3.7	105

概要

インテル® Xeon® Silver 4116プロセッサ	12	2.1	16.50	2400	あり	あり	2.4、3.0	85
インテル® Xeon® Silver 4114プロセッサ	10	2.2	13.75	2400	あり	あり	2.5、3.0	85
インテル® Xeon® Silver 4112プロセッサ	4	2.6	8.25	2400	あり	あり	2.9、3.0	85
インテル® Xeon® Silver 4108プロセッサ	8	1.8	11.00	2400	あり	あり	2.1、3.0	85
インテル® Xeon® Bronze 3106プロセッサ	8	1.7	11.00	2133	なし	あり	N/A	85
インテル® Xeon® Bronze 3104プロセッサ	6	1.7	8.25	2133	なし	あり	N/A	85
<p>¹この列に示されている仕様は以下を表しています：(すべてのコアの最大ターボ周波数、1つのコアの最大ターボ周波数)。ターボ機能を持たないプロセッサは「N/A」と表されています。</p>								

使用可能なプロセッサ

免責事項

マルチコアは、特定のソフトウェア製品のパフォーマンス向上を意図して設計されています。一部のお客様またはソフトウェアアプリケーションは、このテクノロジーの使用によって恩恵を受けません。パフォーマンスおよびクロック周波数は、アプリケーションの作業負荷とハードウェアおよびソフトウェアの構成によって異なります。インテルのナンバリング、ブランド設定、または命名は、より高いパフォーマンスを評価するものではありません。

色

黒

互換性

なし

拡張スロット (詳しくは、システムボードのセクションを参照してください) **スロット0:** 機械のみ、背面バルクヘッド取り付けのみが必要なデバイスで、または2nd CPUライザーが取り付けられている場合に使用

スロット1:
PCI Express Gen3 x4 - オープンエンド、CPUに接続*

スロット2:
PCI Express Gen3 x16 - CPUに接続

スロット3:
PCI Express Gen3 x4 - オープンエンド、PCHに接続*

スロット4:
PCI Express Gen3 x8 — オープンエンド、CPUに接続 (2nd M.2スロットにSSDが取り付けられている場合、このスロットは×4スロットとして動作します) *

スロット5:
PCI Express Gen3 x16 - CPUに接続

スロット6:
PCI Express Gen3 x4 - オープンエンド、PCHに接続*

M.2スロット1:
M.2 PCIe Gen 3 x4 - CPU接続、最大80 mmのストレージデバイスが利用可能

概要

M.2スロット2:

M.2 PCIe Gen 3 x4 - CPU接続、最大80 mmのストレージデバイスが利用可能

* オープンエンドコネクタでは、より多く帯域幅を使用する (x16など) カードを、より低い帯域幅のコネクタ/スロットに取り付けることができます。

注: Thunderbolt・3 PCIeカードのサポートは2018年の前半に入手可能

拡張ベイ (詳しくは、ストレージのセクションを参照してください) 内蔵3.5インチベイ (音響減衰レールアセンブリが装着済み) × 2
外付け5.25インチベイ × 2

- 3番目および4番目の3.5インチHDD (それぞれ1つの外付けベイを占有)
- 3番目および4番目の2.5インチHDD/SSDは2:1のキャリア内の1つの外付けベイを占有

専用の9.5 mmスリム オプティカルドライブベイ × 1

前面I/O

- スタンダード: 電源ボタン、ヘッドセットオーディオポート × 1、USB 3.1 G1 Type A × 4 (充電 × 1)
- プレミアム (オプション): 電源ボタン、ヘッドセットオーディオポート × 1、USB 3.1 G2 Type C × 2、USB 3.1 G1 Type A × 2 (充電 × 1)
- オプション: SDリーダー

内蔵I/O

USB 3.1 G1 (またはUSB 3.0) シングルポートヘッダー × 1、USB 2.0シングルポートヘッダー × 1、およびUSB 2.0デュアルポートヘッダー × 1

背面I/O

USB 3.1 G1 (またはUSB 3.0) Type Aポート × 6、1Gbe LANポート (サポートしているIntel® AMT × 1) × 2、オーディオ: ライン出力 × 1、ライン入力 × 1 (ライン入力はマイクとして再割り当て可能)、PS/2マウスポート × 1、PS/2キーボードポート × 1、背面電源ボタン × 1
オプション: シリアルポート × 1 (ケーブルは背面バルクヘッドまで)

**サポートされる
インターフェイス**

SDカードスロット (オプション)
6チャンネルSATA/Aインターフェイス (6.0 Gb/sで6)
6つのチャンネルは、eSATA CTO/AMOキットと使用する場合eSATA構成可能です (ホットプラグ/ホットスワップはサポートされていない)
USB 2.0、USB 3.1 G1 (またはUSB 3.0)、USB 3.1 G2 (オプション)

オンボードRAIDサポート

SATA RAID 0ストライプアレイ構成
SATA RAID 1ミラーアレイ構成
SATA RAID 10ストライプ/ミラーアレイ構成
SATA RAID 5パリティアレイ構成

シャーシ寸法

(高さ × 幅 × 奥行き)

H: 445 mm
W: 169 mm
D: 465 mm

パッケージ寸法

H: 610 mm
W: 313 mm
D: 593 mm

ラック寸法

4U

質量

正確な質量は構成によって異なります (システム質量のみ)。
最小: 13.1 kg
標準: 13.6 kg
最大: 23.9 kg

動作保証温度

動作時: 5 ~ 35°C
非動作時: -40 ~ 60°C

概要

注：1524 m (5,000フィート) を超える海拔では、最大動作温度は、高度が305 m (1,000フィート) 増加するごとに1°C (1.8°F) 下がります。

湿度

動作時：10～85%の相対湿度、結露なし、35°C最大湿球
非動作時：10～90%の相対湿度、結露なし、35°C最大湿球

動作保証高度（非加圧）

動作時：3,048 m
非動作時：9,144 m

注：1524 m (5,000フィート) を超える海拔では、最大動作温度は、高度が305 m (1,000フィート) 増加するごとに1°C (1.8°F) 下がります。

電源装置

1000 Wワイドレンジ、アクティブな電圧自動補正機能、90%効率、6ピングラフィックス電源ケーブル × 2付属（グラフィックス電源ケーブルは6/8ピン交換可能）

Z6 G4 1000 W電源供給装置の効率に関するレポートについては、このリンクを参照してください：
https://plugloadsolutions.com/psu_reports/HP_D15-1K0P1A_1000W_ECOS%204838_Report.pdf（英語サイト）

ワークステーションISV 認定

以下の最新の認定一覧を参照してください。
<http://www8.hp.com/us/en/campaigns/workstations/industries-and-partners.html>（英語サイト）

サポートされるコンポーネント

プロセッサ

	工場出荷時に設定	オプションキット	オプションキット 製品番号	サポートに関する注
インテル® Xeon® スケーラブル CPU				
インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサ	Y	N		
インテル® Xeon® Platinum 8160 プロセッサ	Y	Y	1XM35AA	
インテル® Xeon® Gold 6152 プロセッサ	Y	Y	1XM36AA	
インテル® Xeon® Gold 6154 プロセッサ	Y	N		
インテル® Xeon® Gold 6148 プロセッサ	Y	Y	1XM37AA	
インテル® Xeon® Gold 6142 プロセッサ	Y	Y	1XM38AA	
インテル® Xeon® Gold 6136 プロセッサ	Y	Y	1XM39AA	
インテル® Xeon® Gold 6140 プロセッサ	Y	Y	1XM40AA	
インテル® Xeon® Gold 6134 プロセッサ	Y	Y	1XM41AA	
インテル® Xeon® Gold 6132 プロセッサ	Y	Y	1XM42AA	
インテル® Xeon® Gold 6130 プロセッサ	Y	Y	1XM43AA	
インテル® Xeon® Gold 6128 プロセッサ	Y	Y	1XM44AA	
インテル® Xeon® Gold 5120 プロセッサ	Y	Y	1XM45AA	
インテル® Xeon® Gold 5118 プロセッサ	Y	Y	1XM46AA	
インテル® Xeon® Gold 5122 プロセッサ	Y	Y	1XM47AA	
インテル® Xeon® Silver 4116 プロセッサ	Y	Y	1XM48AA	
インテル® Xeon® Silver 4114 プロセッサ	Y	Y	1XM49AA	
インテル® Xeon® Silver 4112 プロセッサ	Y	Y	1XM50AA	
インテル® Xeon® Silver 4108 プロセッサ	Y	Y	1XM51AA	
インテル® Xeon® Bronze 3106 プロセッサ	Y	Y	1XM52AA	
インテル® Xeon® Bronze 3104 プロセッサ	Y	Y	1XM53AA	

* マルチコアは、特定のソフトウェア製品のパフォーマンス向上を意図して設計されています。一部のお客様またはソフトウェアアプリケーションは、このテクノロジーの使用によって恩恵を受けません。64ビットのコンピューティングシステムが必要です。パフォーマンスは、ハードウェアおよびソフトウェア構成によって異なります。インテルのナンバリング、ブランド設定、または命名は、より高いパフォーマンスを評価するものではありません。

モニター/ ディスプレイ

	工場出荷時に設定	オプションキット	オプションキット 製品番号	サポートに関する注
HP Zディスプレイ Z22n G2		Y	1JS05AA	
HP Zディスプレイ Z23n G2		Y	1JS06AA	
HP Zディスプレイ Z24i G2		Y	1JS08AA	
HP Zディスプレイ Z24n G2		Y	1JS09AA	
HP Zディスプレイ Z24nf G2		Y	1JS07AA	
HP Zディスプレイ Z27n G2		Y	1JS10AA	
HP Zディスプレイ Z27s (4Kディスプレイ)		Y	J3G07AA	

HPのすべてのオペレーティングシステムでサポート
画面サイズは対角線を測定

サポートされるコンポーネント

ストレージ/ハードディスク ドライブ

SASハードディスク ドライブ

HPワークステーション用のSASハードディスク ドライブ	工場出荷時に設定	オプション キット	オプション キット 製品番号	サポートに 関する注
HP 300GB 15k SAS SFF	Y	Y	L5B74AA	

注 : SASコントローラー アドインカードが必要

SATAハードディスク ドライブ

HPワークステーション用のSATA (シリアルATA) ハードディスク ドライブ	工場出荷時に設定	オプション キット	オプション キット 製品番号	サポートに 関する注
500GB SATA 7200RPM 6Gb/s 3.5インチHDD	Y	Y	LQ036AA	
500GB SATA 7200RPM 6Gb/s OPAL2 SFF 3.5インチHDD	Y	Y	D8N29AA	
1TB SATA 7200RPM 3.5インチHDD	Y	Y	LQ037AA	
2TB SATA 7200RPM HDD	Y	Y	QB576AA	
4TB SATA 7200RPM Ent 3.5インチHDD	Y	Y	K4T76AA	

注 :

最大4台の3.5インチ7200 rpm SATAドライブ : 500 GB、1.0、2.0、4.0 TB。最大システムHDDストレージ : 16.0 TB

サポートされるコンポーネント

SATAソリッドステート ドライブ

	工場出荷時 に設定	オプション キット	オプション キット 製品番号	サポートに 関する注
ワークステーション用のHPソリッドステートドライブ (SSD)				
HP 256GB SATA SSD	Y	Y	A3D26AA	
HP 512GB SATA SSD	Y	Y	D8F30AA	
HP 1TB SATA SSD	Y	Y	F3C96AA	
HP 2TB SATA SSD	Y	Y	Y6P08AA	

PCIeソリッドステート ドライブ

	工場出荷時 に設定	オプション キット	オプション キット 製品番号	サポートに 関する注
HPワークステーション用のPCIe SSD				
HP Z Turboドライブ256GB MLC Z4/Z6 G4 SSDキット	Y	Y	1PD56AA	
HP Z Turboドライブ512GB MLC Z4/Z6 G4 SSDキット	Y	Y	1PD57AA/AT	
HP Z Turboドライブ1TB MLC Z4/Z6 G4 SSDキット	Y	Y	1PD58AA	
HP Z Turboドライブ256GB TLC Z4/Z6 G4 SSDキット	Y	Y	1PD59AA/AT	
HP Z Turboドライブ512GB TLC Z4/Z6 G4 SSDキット	Y	Y	1PD60AA	
HP Z Turboドライブ1TB TLC Z4/Z6 G4 SSDキット	Y	Y	1PD61AA	
HP Z Turboドライブ256GB Z4/Z6 G4 SEDキット	Y	Y	2SA31AA	
HP Z Turboドライブ512GB Z4/Z6 G4 SEDキット	Y	Y	2SA32AA	
HP Z TurboドライブQuad Pro				
HP Z TurboドライブQuad Pro 2x256GB PCIe SSD	Y	Y	N2M98AA	1
HP Z TurboドライブQuad Pro 2x512GB PCIe SSD	Y	Y	N2M99AA	1
HP Z TurboドライブQuad Pro 2x1TB PCIe SSD	Y	Y	T9H99AA	1
HP Z TurboドライブQuad Pro 256GB SSDモジュール	N	Y	N2N00AA	2
HP Z TurboドライブQuad Pro 512GB SSDモジュール	N	Y	N2N01AA	2
HP Z TurboドライブQuad Pro 1TB SSDモジュール	N	Y	T9J00AA	2

注1 : デュアルM.2 SSDモジュールおよびキャリア

注2 : M.2 SSDモジュールのみ、Quad Proキャリアに取り付けられるように設計されている

ハードディスク ドライ ブコントローラー

	工場出荷時 に設定	オプション キット	オプション キット 製品番号	サポートに 関する注
SASコントローラー				
MicroSemi SmartHBA2100-4i4e SASコントローラー	Y	Y	1FV90AA	

グラフィックス

	工場出荷 時に設定	オプション キット	オプション キット 製品番号	サポート に関する 注	サポート される カード枚数
グラフィックス ケーブルアダプター					
HP DisplayPort - VGAアダプター	Y	Y	AS615AA		

サポートされるコンポーネント

HP DisplayPort - HDMIアダプター	Y	Y	K2K92AA	
HP DisplayPort - デュアル リンクDVIアダプター	Y	Y	NR078AA	1
HP DisplayPort - DVI-Dアダプター	Y	Y	FH973AA	1
HP DisplayPort - DVI-Dアダプター (2パック)	Y	N		1
HP DisplayPort - DVI-Dアダプター (4パック)	Y	N		1
HP DisplayPort - DVI-Dアダプター (6パック)	Y	N		1
NVIDIA® SLIグラフィックス コネクタ	Y	Y	PP654A	1
NVIDIA® SLI 3スロット グラフィックス コネクタ	Y	Y	2YY85AA	1
エントリー3D				
NVIDIA® Quadro® P400 1st GFX 2GBグラフィックス	Y	Y	1ME43AA/AT	2
NVIDIA® Quadro® P600 1st GFX 2GBグラフィックス	Y	Y	1ME42AA/AT	2
AMD FirePro® W2100 2GBグラフィックス	Y	Y	J3G91AA/AT	2
ミッドレンジ3D				
NVIDIA® Quadro® P1000 1st GFX 4GBグラフィックス	Y	Y	1ME01AA/AT	2
NVIDIA® Quadro® P2000 1st のGFX 5GBグラフィックス	Y	Y	1ME41AA/AT	2
AMD Radeon® Pro WX 3100 4GBグラフィックス	Y	Y	2TF08AA	2
AMD Radeon® Pro WX 4100 4GBグラフィックス	N	Y	Z0B15AA/AT	2
ハイエンド3D				
NVIDIA® Quadro® P4000 1st のGFX 8GBグラフィックス	Y	Y	1ME40AA/AT	2
NVIDIA® Quadro® P5000 1st GFX 16GBグラフィックス	Y	Y	Z0B13AA/AT	2
NVIDIA® Quadro® P6000 1st GFX 24GBグラフィックス	Y	Y	Z0B12AA/AT	1
AMD Radeon® Pro WX 7100 1st GFX 8GBグラフィックス	Y	Y	Z0B14AA/AT	2

注 : NVIDIA® Quadro® GP100およびAMD Radeon® Pro WX 9100のサポートは2018年の前半に入手可能

メモリ	CTO	工場出荷時に設定	オプションキット	オプションキット製品番号	サポートに関する注
DDR4-2666 ECCレジスタ付きDIMM					
	8GB (1x8GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	Y	Y	1XD84AA/AT	
	16GB (2x8GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	Y			
	24GB (3x8GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	Y			
	32GB (4x8GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	Y			
	48GB (6x8GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	Y			
	16GB (1x16GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	N	Y	1XD85AA/AT	
	32GB (2x16GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	Y			
	48GB (3x16GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	Y			
	64GB (4x16GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	Y			
	96GB (6x16GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	Y			
	32GB (1x32GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	N	Y	1XD86AA/AT	
	64GB (2x32GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	Y			
	96GB (3x32GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	Y			
	128GB (4x32GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	Y			
	192GB (6x32GB) DDR4-2666 ECC Reg 1CPUメモリ	Y			

サポートされるコンポーネント

32GB (4x8GB) DDR4-2666 ECC Reg 2CPUメモリ	Y
48GB (6x8GB) DDR4-2666 ECC Reg 2CPUメモリ	Y
64GB (8x8GB) DDR4-2666 ECC Reg 2CPUメモリ	Y
96GB (12x8GB) DDR4-2666 ECC Reg 2CPUメモリ	Y
64GB (4x16GB) DDR4-2666 ECC Reg 2CPUメモリ	Y
96GB (6x16GB) DDR4-2666 ECC Reg 2CPUメモリ	Y
128GB (8x16GB) DDR4-2666 ECC Reg 2CPUメモリ	Y
192GB (12x16GB) DDR4-2666 ECC Reg 2CPUメモリ	Y
128GB (4x32GB) DDR4-2666 ECC Reg 2CPUメモリ	Y
192GB (6x32GB) DDR4-2666 ECC Reg 2CPUメモリ	Y
256GB (8x32GB) DDR4-2666 ECC Reg 2CPUメモリ	Y
384GB (12x32GB) DDR4-2666 ECC Reg 2CPUメモリ	Y

注：

HP Z6 G4 Workstationでサポートされるメモリ構成の詳細については、このドキュメントの「システム技術仕様-システム ボード」セクションを参照してください。

各プロセッサは、DDR4メモリのチャンネルを最大6つサポートします。十分なパフォーマンスを実現するには、少なくとも1つのDIMMが各チャンネルに挿入されている必要があります。

シングルプロセッサ構成では、6つのDIMMスロットを使用できます。2nd CPUおよびメモリ モジュールでは、追加のDIMMスロットを6つ使用できます。

CPUは、メモリ クロックの速度を決定します。システムで2400 MT/秒対応のCPUが使用されている場合、メモリの最大実行速度は、メモリの指定されている速度にかかわらず2400 MT/秒です。

レジスタ付きDDR4 DIMMのみがサポートされます。
DDR3 DIMMはサポートされません。

注2：2nd CPUを含むZ6 G4構成には、HP Z6メモリ冷却装置が必要です。これは、CTO (2JA81AV) とAMO (2HW44AA) の両方で使用できます。システムメモリの合計が32 GBを超えるZ6 G4構成には、HP Z6メモリ冷却装置が必要です。これは、CTO (2JA81AV) とAMO (2HW44AA) の両方で使用できます。

マルチメディアおよびオーディオ デバイス

サポートされるコンポーネント

マルチメディアおよびオーディオ デバイス

	工場出荷時に設定	オプション キット	オプション キット 製品番号	サポートに 関する注
内蔵Realtek HD ALC221オーディオ	Y	N		

オプティカルおよびリムーバブルストレージ

	工場出荷時に設定	オプション キット	オプション キット 製品番号	サポートに 関する注
HPオプティカルドライブ (スリムライン)				
HP 9.5 mmスリムブルーレイディスクライター	Y	Y	K3R65AA	
HP 9.5 mmスリムDVD ROM	Y	Y	K3R63AA	
HP 9.5 mmスリムDVDライター	Y	Y	K3R64AA	
HP SDカードスロット				
HP SD 4カードスロット	Y	Y	Y0L99AA	

実際の速度は異なる場合があります。DVD-RAM (DVDライター) のサポートはありません。市販のDVDムービーまたはその他の著作権で保護されているマテリアルのコピーは禁止されています。オリジナルのマテリアルの作成や格納およびその他の合法的使用を意図しています。二重層ディスクは、単一層ディスクよりも多くのデータを格納できます。ただし、このドライブで書き込んだ二重層ディスクは、多くの既存の単一層DVDドライブおよびプレーヤーとは互換性がない場合があります。

ブルーレイでは、特定のディスク、デジタル接続、互換性、またはパフォーマンスに関する問題が発生する場合がありますが、これによって製品が故障することはありません。すべてのシステム上での完全な再生は保証されていません。一部のブルーレイタイトルは、再生するためにDVIまたはHDMIによるデジタル接続やHDCP対応のディスプレイが必要になる場合があります。このワークステーションではHD-DVDムービーは再生できません。

ネットワークおよび通信

	工場出荷時に設定	オプション キット	オプション キット 製品番号	サポートに 関する注
HP i350-T2 PCIeデュアルポートギガビットNIC	Y	Y	V4A91AA	
Intel® i350-T4 PCIe 4ポートギガビットNIC	N	Y	W8X25AA	
インテル® Ethernet I210-T1 PCIe x1 Gb NIC	Y	Y	E0X95AA	
HPデュアルポート10GBase-T NICモジュール	Y	Y	1QL49AA	
インテル® 8265 802.11 a/b/g/n/ac + BT PCIe WLAN	N	Y	1QL48AA	
インテル® X550-T2 10GbEデュアルポートNIC	Y	Y	1QL46AA	
インテル® X710-DA2 10GbE SFP+ デュアルポートNIC	Y	Y	1QL47AA	
HP 10GbE SFP+ SRトランシーバー	Y	Y	C3N53AA	

ラックおよび物理セキュリティ

サポートされるコンポーネント

ラックおよび物理セキュリティ

	工場出荷時に設定	オプションキット	オプションキット 製品番号	サポートに関する注
HP Z4/Z6側面パネルバレルキーロック	Y	N		
HPソレノイドロック/フードセンサー	Y	N		
HP Z4/Z6ラックレールキット	N	Y	2HW42AA	
HPセキュリティロックケーブル（施錠式）10 mm	N	Y	T1A62AA	

入カデバイス

	工場出荷時に設定	オプションキット	オプションキット 製品番号	サポートに関する注
ビジネススリムPS/2有線キーボード	Y	Y	N3R86AA	
USBビジネススリム有線キーボード	Y	Y	N3R87AA	
USBプレミアム有線キーボード	Y	Y	Z9N40AA	
3Dconnexion CADMouse	Y	Y	M5C35AA	
HPオプティカルUSBマウス	Y	Y	QY777AA	
HP PS/2マウス	Y	Y	QY775AA	

その他のハードウェア

	工場出荷時に設定	オプションキット	オプションキット 製品番号	サポートに関する注
HP国際エネルギースター®認定構成	Y			
HP Zプレミアム前面I/O USB-A × 2 USB-C × 2	Y	Y	1XM32AA	
HP Z6 G4メモリ冷却装置	Y	Y	2HW44AA	注1
HP内蔵USBポートキット	N	Y	EM165AA	注2
HP eSATA 2ポートPCIバルクヘッドキット	Y	Y	GM110AA	
HPシリアルポートアダプター	Y	Y	PA716A	
HPワークステーションマウスパッド	Y			

注1：2nd CPUを含むZ6 G4構成には、HP Z6メモリ冷却装置が必要です。これは、CTO（2JA81AV）とAMO（2HW44AA）の両方で使用できます。システムメモリの合計が32 GBを超えるZ6 G4構成には、HP Z6メモリ冷却装置が必要です。これは、CTO（2JA81AV）とAMO（2HW44AA）の両方で使用できます。

注2：HP内蔵USBポートキットには、1つのUSB 2.0タイプAコネクタが付属しています。

ソフトウェア

	工場出荷時に設定	オプションキット	オプションキット 製品番号	サポートに関する注
Sobeyビデオ編集SW	Y	N		
SW HP RGS for Z	Y	N		

サポートされるコンポーネント

オペレーティング システム

Windows 10 Pro 64ビット

64ビット版Windows 7 Professional

HP Linux® Installer Kit

Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL) ワークステーション-使用許諾契約書 (1年)

注1 : この2つ目のOSは、最初のOSとしてHP Linux® Installer Kitとともにする必要があります。

注2 : RHEL 6および7、SUSE Linux® Enterprise Desktop 11、およびUbuntu 14.04の64ビットOSバージョン用のドライバーを含みます。

サポートに関する注

注2

注1

システム技術仕様

システムボード

システムボードフォームファクター メインシステムボード：
24 × 31 cm
9.6 × 12.2インチ

2nd CPU/メモリボード（オプション）：
14.9 × 29.2 cm
5.85 × 11.50インチ

プロセッサースOCKET

FCLGA3647（ソケットP）
システムボード上の1つ目のCPU
オプションの2nd CPU/メモリモジュール上の2nd CPU

CPUバス速度

UPI：最大10.4 GT/秒（プロセッサによって異なります）

チップセット

インテル® C622チップセット

スーパーI/Oコントローラー

Nuvoton SI015

メモリ拡張スロット

システムボード（CPU0）上に6 + オプションの2nd CPU/メモリモジュール（CPU1）上に6

サポートされるメモリの種類

DDR4、RDIMM（レジスタ付き）、ECC：8 GB、16 GB、および32 GB

メモリモード

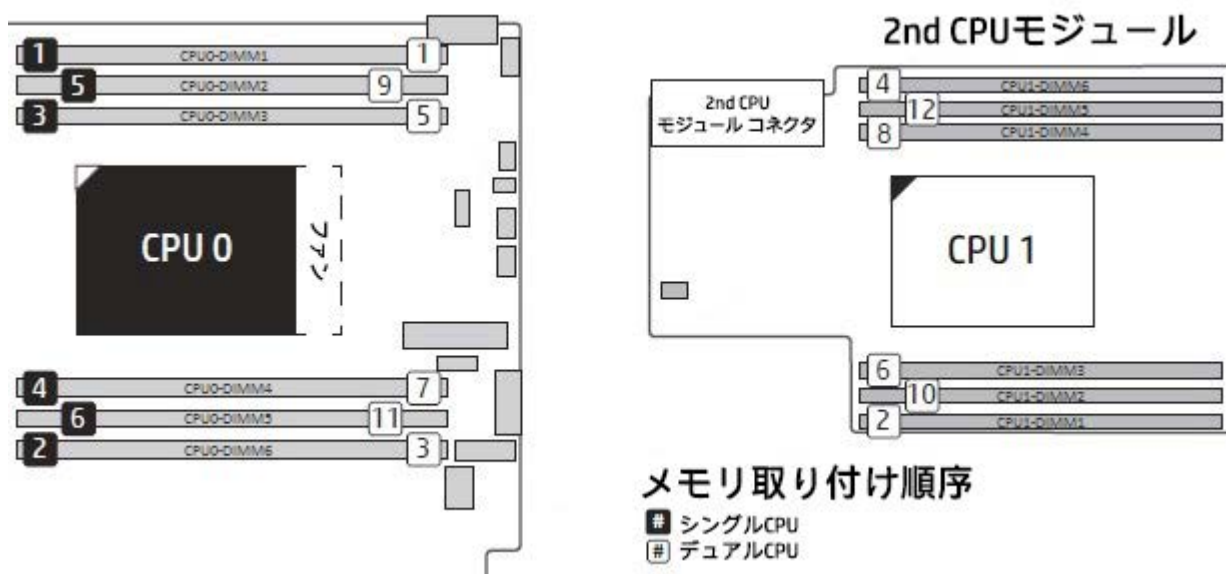
NUMA（Non-Uniform Memory Architecture）、メモリノードインターリーブ

サポートされるメモリの速度

2133 Mt/秒、2400 MHz、および2666 MT/秒

メモリ取り付け順序：

シングルおよびデュアルプロセッサ構成の取り付け順序



最大メモリ

2つのプロセッサで最大384 GBをサポートします。

システム技術仕様

サポートされるメモリ構成

- レジスタ付きECC DIMMのみがサポートされます。
- 対応するプロセッサが取り付けられていない場合は、メモリ モジュールをメモリ スロットに取り付けしないでください。
- メモリ モジュールが1つのプロセッサのみに対して取り付けられるデュアル プロセッサ構成はサポートされていません。

PCI Expressコネクタ

スロット0 :

機械のみ、背面バルクヘッド取り付けのみが必要なデバイスで、または2nd CPUライザーが取り付けられている場合に使用

スロット1 :

PCI Express Gen3 x4 - オープンエンド、CPUに接続*

スロット2 :

PCI Express Gen3 x16 - CPUに接続

スロット3 :

PCI Express Gen3 x4 - オープンエンド、PCHに接続*

スロット4 :

PCI Express Gen3 x8 - オープンエンド、CPUに接続 (2nd M.2スロットにSSDが取り付けられている場合、このスロットは×4スロットとして動作します) *

スロット5 :

PCI Express Gen3 x16 - CPUに接続

スロット6 :

PCI Express Gen3 x4 - オープンエンド、PCHに接続*

M.2スロット1 :

M.2 PCIe Gen 3 x4 - CPU接続、最大80 mmのストレージ デバイスが利用可能

M.2スロット2 :

M.2 PCIe Gen 3 x4 - CPU接続、最大80 mmのストレージ デバイスが利用可能

* オープンエンドコネクタでは、より多く帯域幅を使用する (x16など) カードを、より低い帯域幅のコネクタ/スロットに取り付けることができます。

サポート対象のドライブ
インターフェイス

SATA SATA @6Gb/s × 6、RAID 0、1、およびNCQをサポートします。
工場出荷時に内蔵されるRAIDはMicrosoft Windowsのみです。

Serial Attached SCSI オプションのPCIeカードが必要

**工場出荷時設定
のRAID**

- RAID 0構成 - ストライプアレイ
- RAID 1構成 - ミラーアレイ
- RAID 10ストライプおよびミラーアレイ

* HW RAID機能はLinux®ではサポートされていません。代わりに、Red Hat®オペレーティングシステムで提供されているSW RAID機能を使用してください。

**内蔵グラフィック
ス** なし

**ネットワーク
コントローラー** 内蔵のIntel® I219LM GbE LAN

システム技術仕様

次の管理機能をサポートします : Intel® AMT11.2、TXT、DASH 1.1、WOL、VLAN、およびPXE 2.1

1 GbE用の内蔵のインテルX722
 サポートされるデータレート : 1000 Mb/秒
 準拠規格 : IEEE 802.1as/1588v2、802.1p、802.1Q、802.3、802.3ab、802.3az、802.3x
 最大16個のUDP/TCPプログラマブルフィルター
 バスアーキテクチャ : PCIe 3.0
 UEFIおよびPXEブートROMのサポート
 インテルiWARPのサポート (RDMA)
 ネットワーク転送速度 :
 1000BASE-T (全二重) 2000 Mb/秒
 管理機能 : WOL (最大省電力を除く)、自動MDI
 クロスオーバー、PXE、クワッドハッシュフィルタリング、RSS、高度なケーブル診断

	外部SATAポート (eSATA)	オプションのeSATA*ケーブルキットで構成可能なすべてのSATAポートでサポートされます *ホットプラグ/ホットスワップはeSATAではサポートされていません
USBコネクタ	前面	前面のUSBは選択されているFIOモジュールによって異なります : - スタンダード : USB 3.1 G1 Type A × 4 (充電 × 1) - プレミアム : USB 3.1 G2 Type C × 2、USB 3.1 G1 Type A × 2 (充電 × 1)
	背面	USB 3.1 G1 Type A × 6
	内部	USB 3.1 G1シングルポートヘッダー × 1 USB 2.0シングルポートヘッダー × 1 USB 2.0デュアルポートヘッダー × 1
HD内蔵オーディオ	Realtek ALC221	
フラッシュROM	あり	
CPUファンヘッダー	CPUソケットごとに1つ	
背面シャーシファンヘッダー	あり	
前面PCIファンヘッダー	あり	
CMOSバッテリーホルダー - リチウム	あり	
内蔵Trusted Platform Module	TPM (Trusted Platform Module) 2.0 (Infineon SLB 9670) Common Criteria EAL4+認定 ファームウェアv7.80によりFIPS 140-2認定モードに交換可能 TPM認定製品のリスト : https://trustedcomputinggroup.org/membership/certification/tpm-certified-products/ (英語サイト)	
電源装置ヘッダー	あり	
電源スイッチ、電源ランプ、およびハードディスクドライブLEDヘッダー	あり	
パスワードクリアジャンパー	あり	
シリアルポート	内蔵ヘッダー × 1	
パラレルポート	なし	
キーボード/マウス	USBまたはPS/2	
フードロックヘッダー	あり	
フードセンサーヘッダー	あり	
メモリファン	CPUあたりメモリファンヘッダー × 1	

システム技術仕様

AUXイン（オーディオ） なし

Z6 の必要な電源装置情報

電源装置	1000 W 90%効率、カスタムPSU (ワイドレンジ、アクティブ PFC)	
動作電圧範囲	90 ~ 269 VAC	
定格電圧範囲	100 ~ 127 VAC 200 ~ 240 VAC	118 VAC
定格周波数	50 ~ 60 Hz	400 Hz
動作周波数範囲	47 ~ 66 Hz	393 ~ 407 Hz
定格入力電流	12 A @ 100 ~ 127 VAC 6.3 A @ 200 ~ 240 VAC	12A @ 118 VAC

放熱
(構成およびソフトウェアによって異なります) 標準 = 2467 btu/時
最大 = 4112 btu/時

電源装置ファン 80 × 25 mm 変速

国際エネルギー スター®への準拠
(構成によって異なります) あり

80 PLUS®準拠

あり、90%効率
Z6 G4 1000 W 電源供給装置の効率に関するレポートについては、このリンクを参照してください：https://plugloadsolutions.com/psu_reports/HP_D15-1K0P1A_1000W_ECOS%204838_Report.pdf (英語サイト)

115 V で FEMP スタンバイ電源準拠
(S5 で 1W 未満 - 電源切断) あり

230 V で EuP 準拠
(S5 で 0.5 W 未満 - 電源切断) あり

220 V で CECP 準拠
(S3 で 4W 未満 - RAM にサスペンド) あり。構成によって異なります

スリープモードでの電力消費
(国際エネルギー スター®の定義どおり) - RAM にサスペンド (S3)
(すぐに利用可能な PC) 20 W 以下

内蔵セルフテストランプ あり

耐サージ機能付フルレンジ連続供給電源装置
(最大 2000 V の電力サージに耐えます) あり

センサー ヘッダー

前面のユーザー インターフェイス (電源スイッチ、電源ランプ、HDDランプ、スピーカー) ケーブルに統合

内蔵Gigabit Ethernet 内蔵インテル® I-218 Gbit LAN

CMOSクリア ボタン あり

システム技術仕様

システム構成

Z6 G4 構成例#1	プロセッサ	インテル Xeon 3104 (6 コア) × 1					
	メモリ	8GB DDR4-2666 (レジスタ付き DIMM) × 1					
	グラフィックス	NVIDIA Quadro P400 × 1					
	ディスク/オプティカル	500GB SATA 7200 × 1/スリム DVD-ROM SATA × 1					
	電源装置	1000 W 90%カスタム PSU					
	その他	該当なし					

エネルギー消費		115 VAC		230 VAC		100 VAC	
		LAN 有効	LAN 無効	LAN 有効	LAN 無効	LAN 有効	LAN 無効
	Windows アイドル (S0)	54.109		54.586		54.906	
	Windows ビジー標準 (S0)	94.256		94.275		94.043	
	Windows ビジー最大 (S0)	95.992		95.268		95.643	
	スリープ (S3)	6.219	6.205	6.319	6.306	6.334	6.239
	オフ (S5)	3.354	3.343	3.521	3.341	3.350	3.342
	ゼロパワーモード (ErP)	0.209		0.388		0.195	

放熱効率 (btu/時)		115 VAC		230 VAC		100 VAC	
		LAN 有効	LAN 無効	LAN 有効	LAN 有効	LAN 無効	LAN 有効
	Windows アイドル (S0)	184.619		186.247		187.339	
	Windows ビジー標準 (S0)	321.601		321.666		320.875	
	Windows ビジー最大 (S0)	327.524		325.054		326.334	
	スリープ (S3)	21.219	21.171	21.561	21.516	21.611	21.287
	オフ (S5)	11.444	11.406	12.014	11.399	11.430	11.403
	ゼロパワーモード (ErP)	0.713		1.323		0.665	

Z6 G4 構成例#2	プロセッサ	インテル Xeon 4108 (8 コア) × 1					
	メモリ	8GB DDR4-2666 (レジスタ付き DIMM) × 4					
	グラフィックス	NVIDIA Quadro P2000 × 1					
	ディスク/オプティカル	1TB SATA 7200 × 2/スリム DVDRW SATA × 1					
	電源装置	1000 W 90%カスタム PSU					
	その他	該当なし					

エネルギー消費 (ワット数)		115 VAC		230 VAC		100 VAC	
		LAN 有効	LAN 無効	LAN 有効	LAN 無効	LAN 有効	LAN 無効
	Windows アイドル (S0)	61.661		61.531		61.354	
	Windows ビジー標準 (S0)	168.665		167.375		166.535	
	Windows ビジー最大 (S0)	166.097		163.682		169.674	
	スリープ (S3)	7.231	7.177	7.229	7.217	7.324	7.248
	オフ (S5)	3.376	3.366	3.527	3.512	3.354	3.350
ゼロパワーモード (ErP)	0.211		0.386		0.195		

放熱効率 (btu/時)		115 VAC		230 VAC		100 VAC	
		LAN 有効	LAN 無効	LAN 有効	LAN 有効	LAN 無効	LAN 有効
	Windows アイドル (S0)	210.387		209.944		209.340	
Windows ビジー標準 (S0)	575.485		571.084		568.217		

システム技術仕様

	Windows ビジュー最大 (S0)	576.959		575.543		578.928	
	スリープ (S3)	24.672	24.488	24.665	24.624	24.989	24.730
	オフ (S5)	11.519	11.484	12.034	11.983	11.443	11.430
	ゼロパワーモード (ErP)	0.720		1.317		0.665	

Z6 G4 構成例#3 国際エネルギースター プログラムに準拠	プロセッサ	インテル Xeon 6136 (12 コア) × 1					
	メモリ	8GB DDR4-2666 (レジスタ付き DIMM) × 6					
	グラフィックス	NVIDIA QuadroP4000 × 1					
	ディスク/オプティカル	1TB SATA 7200 × 2/スリム DVDRW SATA × 1					
	電源装置	1000 W 90%カスタム PSU					
	その他	該当なし					

エネルギー消費 (ワット数)		115 VAC		230 VAC		100 VAC	
		LAN 有効	LAN 無効	LAN 有効	LAN 無効	LAN 有効	LAN 有効
	Windows アイドル (S0)	79.074		79.109		79.938	
	Windows ビジュー標準 (S0)	324.975		317.991		327.451	
	Windows ビジュー最大 (S0)	328.268		320.296		329.668	
	スリープ (S3)	7.847	7.756	7.878	7.826	7.931	7.852
	オフ (S5)	3.353	3.348	3.535	3.489	3.373	3.355
	ゼロパワーモード (ErP)	0.206		0.386		0.196	

放熱効率 (btu/時)		115 VAC		230 VAC		100 VAC	
		LAN 有効	LAN 無効	LAN 有効	LAN 有効	LAN 無効	LAN 有効
	Windows アイドル (S0)	269.801		269.920		272.748	
	Windows ビジュー標準 (S0)	1108.815		1084.985		1117.262	
	Windows ビジュー最大 (S0)	1120.051		1092.850		1124.827	
	スリープ (S3)	26.774	26.463	26.880	26.702	27.061	26.791
	オフ (S5)	11.441	11.426	12.061	11.904	11.509	11.447
	ゼロパワーモード (ErP)	0.703		1.317		0.669	

Z6 G4 の例 構成#4	プロセッサ	インテル Xeon 8160 (デュアル 24 コア) × 2					
	メモリ	32GB DDR4-2666 (レジスタ付き DIMM) × 12					
	グラフィックス	NVIDIA Quadro P5000 × 2					
	ディスク/オプティカル	2TB SATA 7200 × 4/スリム DVDRW SATA × 1					
	電源装置	1000 W 90%カスタム PSU					
	その他	該当なし					

エネルギー消費 (ワット数)		115 VAC		230 VAC		100 VAC	
		LAN 有効	LAN 無効	LAN 有効	LAN 無効	LAN 有効	LAN 有効
	Windows アイドル (S0)	112.388		115.635		112.102	
	Windows ビジュー標準 (S0)	512.368		490.165		526.905	
	Windows ビジュー最大 (S0)	698.548		673.465		706.461	
	スリープ (S3)	14.208	13.833	14.698	14.487	15.176	13.886
	オフ (S5)	3.511	3.418	3.575	3.570	3.509	3.412
	ゼロパワーモード (ErP)	0.287		0.387		0.272	

システム技術仕様

放熱効率 (btu/時)	115 VAC		230 VAC		100 VAC	
	LAN 有効	LAN 無効	LAN 有効	LAN 有効	LAN 無効	LAN 有効
Windows アイドル (S0)	383.469		394.547		382.492	
Windows ビジー標準 (S0)	1748.120		1672.443		1797.800	
Windows ビジー最大 (S0)	2383.446		2297.863		2410.445	
スリープ (S3)	48.478	47.198	50.150	49.430	51.781	47.379
オフ (S5)	11.980	11.662	12.198	12.181	11.973	11.642
ゼロパワーモード (ErP)	0.979		1.321		0.928	

注：電力消費の測定値は、Intel ターボブーストテクノロジーを活用していません。その結果、電力消費の測定値は、より高くなる場合があります。

定格騒音規制

システム構成 (エントリーレベル)	プロセッサ情報	インテル® Xeon® Gold 6130プロセッサ-2.1 GHz 12C CPU
	メモリ情報	24GB (3x8GB) DDR4-2666 ECCメモリ RDIMM
	グラフィックス情報	NVIDIA® Quadro® P400 2GB × 1
	ディスク/光学ドライブ	500GB SATA 7200 RPM 3.5インチHDD × 1/HP 9.5 mmスリムブルーレイディスクライター × 1
	電源装置	1000 W

定格騒音規制 (ISO 7779およびISO 9296 準拠)	サウンド出力 (LWAd、ベル)	デスク側のサウンド圧力 (LpAm、デシベル)
アイドル	3.3	15
ハードディスクドライブ動作時 (ランダム読み取り)	3.5	18

システム構成 (ミッドレンジ)	プロセッサ情報	インテル® Xeon® Platinum 8168プロセッサ-2.7 GHz 24C CPU
	メモリ情報	96GB (6x16GB) DDR4-2666 ECCメモリ RDIMM
	グラフィックス情報	NVIDIA® Quadro® P6000 24GB × 1
	ディスク/光学ドライブ	4TB 6Gb/s 7200RPM SATA HDD × 2/HP 9.5 mmスリムブルーレイディスクライター × 1
	電源装置	1000 W

定格騒音規制 (ISO 7779およびISO 9296 準拠)	サウンド出力 (LWAd、ベル)	デスク側のサウンド圧力 (LpAm、デシベル)
アイドル	3.8	23
ハードディスクドライブ動作時 (ランダム読み取り)	3.9	23

システム構成 (ハイエンド)	プロセッサ情報	インテル® Xeon® Gold 6136プロセッサ-3.0 GHz 12C CPU × 2
	メモリ情報	192GB (12x16GB) DDR4-2666 ECCメモリ RDIMM
	グラフィックス情報	NVIDIA® Quadro® P6000 24GB × 1

システム技術仕様

ディスク/光学ドライブ	4TB 6Gb/s 7200RPM SATA HDD × 2/HP 9.5 mmスリムブルーレイディスクライター × 1
電源装置	1000 W

定格騒音規制 (ISO 7779およびISO 9296 準拠)	サウンド出力 (LWAd、ベル)	デスク側のサウンド圧力 (LpAm、デシベル)
アイドル	3.8	23
ハードディスクドライブ動作時 (ランダム読み取り)	3.9	24

環境データ

環境条件	動作保証温度	動作時：5～35° C 非動作時：-40～60° C
	湿度	動作時：10～85%のRH、結露なし、35° C最大湿球 非動作時：10～90%のRH、結露なし、35° C最大湿球
	動作保証高度	動作時：3,048 m 1524 m (5,000フィート) を超える海拔では、最大動作温度は、高度が305 m (1,000フィート) 増加するごとに1° C (1.8° F) 下がります。 非動作時：9,144 m
	衝撃（繰り返しなし）	動作時：1/2正弦波：40 g、2～3 ms（～62 cm/秒） 非動作時：1/2正弦波：160 cm/秒、2～3 ms（～105 g） 方形波：422 cm/s、20 g
	振動	ランダム動作時：0.5 g (rms)、5～300 Hz、最大0.0025 g ² /Hz 非ランダム動作時：2.0 g (rms)、5～500 Hz、最大0.0150 g ² /Hz

物理セキュリティおよび保守性

アクセスパネル	工具不要 システム ボードおよびメモリ情報が含まれます。
光学ドライブ	工具不要、キャリアまたはレール不要
ハードディスクドライブ	工具不要 オプションの5.25インチ外付けベイ キャリア
拡張カード	工具不要
プロセッサ ソケット	メイン システム ボード上の1つ目のソケット。オプションの2nd CPU/メモリ モジュール上の2つ目のソケット。
青色のユーザー タッチ ポイント	あり（主な修理可能なコンポーネント上）
色分けされたケーブルおよびコネクタ	あり
メモリ	工具不要
システム ボード	T-15型のネジ回し 2nd CPU/メモリ モジュール：工具不要
コンピューター前面のLED	デュアル カラーの電源/障害ランプ = あり HDD動作ランプ = あり

システム技術仕様

構成レコードソフトウェア	あり
画面上の過熱警告	あり（再起動時のPOST画面）
復元用CD/DVDセット	あり。コンピューターを最初の工場出荷時イメージに復元します。HPサポートから入手できます。
デュアル機能の前面電源スイッチ	あり。4秒押し続けるとリセットスイッチとしても機能します。
南京錠サポート	あり
ケーブルロックサポート	ケンジントンケーブルロック（オプション）：システム全体の盗難およびシステムアクセスを防止します。システム背面の3 mm × 7 mmスロット
ユニバーサルシャーシクランブロックサポート	なし
ソレノイドロックおよびフードセンサー	アクセスパネルソレノイドロック：あり（オプション）。システムへの侵入を防止するためにリモートでアクティブ化されます。 アクセスパネル侵入センサー：あり（オプション）。
リムーバブルメディアの書き込み/起動制御	あり。ユーザーは、ワークステーションのリムーバブルメディアへの書き込みまたはリムーバブルメディアからの起動を防止できます。
電源投入時パスワード（Power-on Password）	あり。権限のないユーザーがワークステーションを起動できないようにします
セットアップパスワード	あり。権限のないユーザーがワークステーションの構成を変更できないようにします
システムPCA上の3.3 V Aux電源ランプ	あり
NIC LED（内蔵）（緑色およびオレンジ色）	あり
CPUおよびヒートシンク	CPUヒートシンクの取り外しにはT-30型のネジ回しが必要です。
電源装置診断LED	あり
前面電源ボタン	あり
背面電源ボタン	あり
前面電源ランプ	あり。白色（正常）、赤色（障害）
前面のハードディスクドライブ動作ランプ	あり。白色
前面のODD動作ランプ	あり。デバイス上
内蔵スピーカー	あり
システム/緊急ROMフラッシュリカバリ	破損したシステムBIOSをリカバリします。
冷却装置	空冷式強制対流
電源装置ファン	80 mm × 80 mm × 25 mm × 1（修理不可）
CPUヒートシンクファン	1つ目のCPU：80 mm × 1 オプションの2nd CPU：60 mm × 25 mm × 1
メモリファン	前面メモリファン：80 mm × 25 mm × 1 メモリダクト空冷ファン：90 mm × 25 mm × 1 2nd CPU/メモリモジュール：60 mm × 25 mm × 1
シャーシファン	前面シャーシファン：120 mm × 25 mm × 1 背面シャーシファン：120 mm × 25 mm × 1
HP Vision Diagnostics Offline Edition	[HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)]によって、多くのコンポーネントに対してオペレーティングシステム外でハードウェアレベルのテストを実施できます。この診断はPCの再起動時に最初にESCキー、次にF2キーを押して起動でき、HPサポートからのダウンロードとして入手できます。
アクセスパネルキーロック	あり。
ACPI対応ハードウェア	ACPI（Advanced Configuration and Power Management Interface）。 <ul style="list-style-type: none"> • システムは低電力モードから復帰できます。

システム技術仕様

- システムの電力消費を制御して、個々のカードおよび周辺機器を、システムの他の要素に影響を及ぼすことなく、低電力または電源切断状態にすることを可能にします。

Trusted Platform Moduleチップ	あり。Infineon TPM 2.0認定
内蔵シャーシハンドル	あり。前面ハンドルおよび専用の背面くぼみ
電源装置	T-15型またはマイナスドライバーが必要です
PCIeカード固定	あり。工具不要 背面（すべて） 中央（フルハイトカード） 前面（エクステンダー付きフルレングスカード）
フラッシュROM	あり
ボード上の診断電源スイッチランプ	あり
パスワードクリアジャンパー	あり
CMOSクリアボタン	あり
CMOSバッテリーホルダー	あり
DIMMコネクタ	あり

BIOS

BIOS 32ビットサービス	Standard BIOS 32-bit Service Directory Proposal v0.4
PCI 3.0サポート	業界標準インターフェイス経由でのPCI Expressの完全BIOSサポート。
ATAPI	ATAPI Removable Media Device BIOS Specificationバージョン1.0。
BBS	BIOS Boot Specification v1.01。
WMIサポート	WMIは、マイクロソフトによるWBEM（Web-Based Enterprise Management）のWindows向けの実装です。WMIは、DMTF（Distributed Management Task Force）CIM（Common Information Model）およびWBEM仕様に完全に準拠しています。

BIOS Boot Spec 1.01+	ワークステーションの起動方法および起動元デバイスを細かく制御できます。
BIOS電源投入	ユーザーは、システムの電源を入れる特定の日付および時刻を定義できます。
ROMベース[コンピューターセットアップ (F10)ユーティリティ]	BIOSによって制御されるシステム構成の設定を確認およびカスタマイズします。

ビデオによるシステム/緊急ROMフラッシュリカバリ複製セットアップ 破損したフラッシュROM内のシステムBIOSをリカバリします。

USBフラッシュデバイス上の読み取り可能なファイル（HpSetup.txt）にBIOS設定を保存します。その後、BiosConfigurationUtility.exeユーティリティは、[コンピューターセットアップ (F10) ユーティリティ]を起動することなく、展開されたシステムでこれらの設定を複製できます。

SMBIOS	システム管理情報用のSystem Management BIOS 2.8。
起動制御	サポート対象のデバイスでリムーバブルメディアからの起動を無効にします。
メモリ変更警告	メモリが取り除かれたり変更されたりした場合、管理コンソールに警告します。
温度警告	シャーシ内の温度状態を監視します。3つのモード： <ul style="list-style-type: none"> • [NORMAL]（正常） - 正常の温度範囲。 • [ALERTED]（警告） - 過熱が検出されています。シャットダウンを回避する、またはより円滑なシステムシャットダウンを提供するためのアクションを行えるよう、フラグが立てられます。 • [SHUTDOWN]（シャットダウン） - 過熱が発生しています。ハードウェアコンポーネントの損傷が発生する前に、警告なしでコンピューターを自動的にシャットダウンします。

リモートROMフラッシュ機能	中央のネットワークコンソールから安全でフェイルセーフのROMイメージ管理を提供します。
ACPI（Advanced Configuration and Power Management Interface）	システムは低電力モード（スリープモード）に入り、そのモードから復帰できます。オペレーティングシステムは、動的なワークロードに基づいてシステムの電力消費を制御できます。個々のカードおよび周辺機器を、システムの他の要素に影響を及ぼすことなく、低電力または電源切断状態にすることを可能にします。

オーナーシップタグ	64ビットオペレーティングシステムとの完全な互換性のためにACPI 5.0をサポートします。BIOSスプラッシュ画面に表示される、不揮発性メモリに記憶されるユーザー定義の文字列。
------------------	---

システム技術仕様

リモート復帰/リモートシャットダウン	システム管理者は、リモート場所から、クライアントコンピューターの電源投入、再起動、および電源切断を行うことができます。
すぐに利用可能なPC (RAMにサスペンド-ACPIスリープ状態S3)	短い再開時間により、非常に低い電力消費を可能にします。
F12によるリモートシステムインストール (PXE 2.1) (サーバーからのリモート起動)	新規または既存のシステムはネットワークを介して起動し、オペレーティングシステムを含むソフトウェアをダウンロードできます。
ROMリビジョンレベル	[コンピューター セットアップ (F10) ユーティリティ]でシステムBIOSリビジョン レベルを報告します。バージョンは、業界標準インターフェイス (SMBIOSおよびWMI) を介して利用できるように、管理SWアプリケーションはこの情報を使用して報告できます。
システムボードリビジョンレベル	管理ソフトウェアはシステムボードのリビジョンレベルを読み取ることができます。リビジョンレベルは、ハードウェアにデジタルでエンコードされており、変更できません。
起動診断 (Power-On Self Test)	選択可能なテストレベルで、起動時のシステム状態を評価します。
新規ハードウェアインストール時の自動セットアップ	システムは、新規ハードウェアの追加を自動検出します。
キーボード不要の操作	システムをキーボードなしで起動できます。
ローカライズされたROMセットアップ	共通BIOSイメージは、[コンピューター セットアップ (F10) ユーティリティ]のメニューを、キーボードマッピングがローカライズされた14言語でサポートします。
アセットタグ	ユーザーまたはMISが不揮発性メモリ内の一意のタグ文字列を設定します。
スロットごとの制御	I/Oスロットパラメーター (オプションのROM有効/無効、バス遅延) を個別に構成できます。
アダプティブ冷却	最適な音響を実現するために、検出されたハードウェア構成に従って制御パラメーターが設定されます。
起動前の診断	(画面表示前の) 重大なエラーは、電源ランプのビープ音および点滅によって報告されます。
業界標準仕様サポート	
業界標準	BIOSによってサポートされるリビジョン
UEFI仕様リビジョン	2.5
ACPI	Advanced Configuration and Power Management Interface、バージョン5.0
ATA (IDE)	ATA/ATAPI-6 (AT Attachment 6 with Packet Interface)、リビジョン3b
CD起動	"El Torito" Bootable CD-ROM Format Specificationバージョン1.0
EDD	- Enhanced Disk Drive Specificationバージョン1.1 - BIOS Enhanced Disk Drive Specificationバージョン3.0
EHCI	Enhanced Host Controller Interface for Universal Serial Bus、リビジョン1.0
PCI	PCI Local Bus Specification、リビジョン2.3 PCI Power Management Specification、リビジョン1.1 PCI Firmware Specification、リビジョン3.0、ドラフト0.7
PCI Express	PCI Express Base Specification、リビジョン2.0 PCI Express Base Specification、リビジョン3.0
PMM	POST Memory Manager Specification、バージョン1.01
SATA	Serial ATA Specification、リビジョン1.0a Serial ATA 3 Gb/s : Serial ATA Specification、リビジョン2.5 Serial ATA 6 Gb/s : Serial ATA Specification、リビジョン3.0
SPD	PC SDRAM Serial Presence Detect (SPD) Specification、リビジョン1.2B
TPM	TPM (Trusted Platform Module) 2.0 (Infineon SLB 9670) Common Criteria EAL4+認定 ファームウェアv7.80によりFIPS 140-2認定モードに交換可能 TCG TPM認定製品のリスト : Http://www.trustedcomputinggroup.org/certification/tpm-certified-products/ (英語サイト)
UHCI	Universal Host Controller Interface Design Guide、リビジョン1.1
USB	Universal Serial Busリビジョン1.1仕様 Universal Serial Busリビジョン2.0仕様

システム技術仕様

Universal Serial Busリビジョン3.1 G1仕様
Universal Serial Busリビジョン3.1 G2仕様
System Management BIOS Reference Specification、バージョン2.8

SMBIOS

外部BIOSシミュレーターについては、次を参照してください：
<http://h20464.www2.hp.com/index.html>（英語サイト）

社会的および環境に対する責任

エコラベル認定および宣言 本製品は以下の承認を受けている、または承認の認定途中です。これらの評価のラベルが1つまたは複数貼付されている場合があります。

- 国際エネルギー スター®（特定の構成で利用可能な省エネルギー機能-Windowsのみ）
- 米国FEMP（Federal Energy Management Program）
- China Energy Conservation Program
- ECO宣言（TED）

Z6 G4は、米国およびカナダで登録済みのEPEAT® Goldです。EPEAT®の登録は国によって異なります。各国の登録状況については、<http://www.epeat.net>（英語サイト）をご覧ください。太陽発電機アクセサリについては、HPのサードパーティ オプション ストア（<http://www.hp.com/go/options>（英語サイト））でキーワード「generator」を検索してください。

バッテリー

本製品のバッテリーは、EU Directive 2006/66/ECに準拠しています。
バッテリーの質量：3 g
バッテリーの種類：リチウム メタル

本製品のバッテリーには以下は含まれてません。

- 質量で5 ppmを超える水銀
- 質量で10 ppmを超えるカドミウム
- 質量で40 ppmを超える鉛

制限された原料使用

本製品は、HP環境関連一般仕様書（GSE）に規定されている原料制限に従っています。

HP Inc.は、European UnionのRoHS（Restriction of Hazardous Substances）Directiveを含め、すべての適用される環境法および規制に準拠するように努めています。HPの目標は、RoHS Directiveの要件を世界各国で満たすことによって、準拠義務を超えることです

低ハロゲンに関する声明

本製品は、電源コード、外部ケーブル、および周辺機器を除き、低ハロゲンです。購入後に取得する保守部品は、低ハロゲンではない場合があります。

廃棄管理およびリサイクル

HP Inc.では、多くの地域で、廃棄するHP製品の返却およびリサイクル プログラムを提供しています。製品をリサイクルする場合は、<http://www.hp.com/jp/hardwarerecycle/>にアクセスするか、最寄りのHP販売オフィスにお問い合わせください。HPに返却された製品は、責任を持ってリサイクル、復元、または廃棄されます。本製品は、適切に廃棄された場合、質量で90%以上リサイクル可能です。

HP Inc.の環境情報

HPの環境に対する取り組みについて詳しくは、以下を参照してください。
[持続可能性レポート](#)

エコラベル認定：
<http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/ecolabels.html>（英語サイト）

ISO 14001証明書：
<http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/operations/envmanagement.html>（英語サイト）

システム技術仕様

追加情報

- 本HP製品は、WEEE（Waste Electrical and Electronic Equipment）Directive - 2002/96/ECに準拠するように設計されています。[製品の取り外しの手順](#)
- 本製品で使用されている25グラムを超えるプラスチック部品には、ISO 11469およびISO1043に従ってマークが付けられています。

梱包

HPワークステーション製品の梱包は、[HPの環境に関する一般的な仕様](#)を満たしています。

- HP標準011-1（環境に関する一般的な仕様）に規定されている制限物質は含まれていません
- オゾン破壊物質（ODS）は含まれていません
- 指定されているすべての重金属（鉛、水銀、カドミウム、または六価クロム）は、合計100 ppmを超える量が含まれていません。
- 梱包材料では使用済みのリサイクルされた材料を最大限使用しています。
- すべての梱包材料はリサイクル可能です
- すべての梱包材料は、分解しやすいように設計されています
- 輸送の燃料効率を向上させるために、梱包品のサイズと質量が削減されています
- プラスチックの梱包材料には、ISO 11469およびDIN 6120標準のフォーマットに従いマークが付けられています

梱包材料

内部

クッションおよびプラスチックバッグは、低密度ポリエチレン（LDPE）で作られています。

外部

外側の箱、オプション製品の箱、および挿入物は段ボール板紙で作られています。

管理機能

業界標準仕様

本製品は、管理機能に関する以下の業界標準仕様を満たしています。

- DASH 1.1（Intel® LAN on motherboard経由）

インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー (AMT)

Intel® AMT（Active Management Technology）11.20

システムの状態または電源の状態にかかわらず、ネットワーク接続されたクライアントシステムをリモート検出、修復、および保護するための最新で最も効果的なツールをIT管理者に提供する、リモート管理機能の高度なセット。AMT 11.20には、以下の高度な管理機能が含まれています。

- 電源管理（投入、切断、リセット、適切なシャットダウン、スリープ、およびハイバネーション）
 - 最大省電力でのサポート（シャットダウンおよびハイバネーションモード）
- ハードウェアインベントリ（BIOSおよびファームウェアリビジョンを含む）
- ハードウェア警告
- エージェントプレゼンス
- システム防御フィルター
- SOL（Serial Over LAN）
- USBリダイレクト（メディアリダイレクト）
- ME WOL（ウェイクオンLAN）。最大省電力が有効になっている場合も機能
- DASH 1.1準拠
- IPv6サポート
- Fast Call for Help - ファイアウォール内部または外部のクライアントは、BIOS画面、定期的な接続、または警告によってトリガーされる接続を介して、ヘルプへの通話を開始できます。
- リモートからの定期保守 - システムが保守のためにITまたはサービスプロバイダーコンソールに接続する時期をあらかじめスケジュールします。
- リモート警告 - 問題が発生した場合にITまたはサービスプロバイダーに自動的に警告します。
- アクセスモニター - セキュリティ要件をサポートするためにIntel® AMTのアクションを監視します。
- PCアラームクロック
- Microsoft NAPサポート
- ホストベースセットアップおよび構成
- 管理エンジン（ME）ファームウェアロールバック

システム技術仕様

- ローカル時間のUTCとの同期
- リモートメモリダンプコマンド - デバッグ用のメモリダンプを作成します。

Intel® vPro™テクノロジー HP Z6 G4 Workstationは、以下のように構成されている場合、Intel® vProテクノロジーをサポートします。

- インテル® Xeon® プロセッサ スケーラブルファミリー
- インテル® C622チップセット
- インテル® I219LM GbE LAN

リモート管理ソフトウェアソリューション HP Z6 G4 Workstationは、以下のリモート管理ソフトウェアコンソールでサポートされています。

- LANDesk Management Suite (HP推奨ソリューション)
- Microsoft System Center Configuration Manager

管理ニーズに関する質問またはサポートについては、<http://www.hp.com/go/easydeploy/> (英語サイト) を参照してください。

System Software Manager SSMに関する質問またはサポートについては、次を参照してください：<http://www.hp.com/go/ssm/> (英語サイト) を参照してください

サービス、サポート、および保証

オンサイト保証およびサービス (注1)：3年間の限定された保証およびサービス提供は、部品および作業に対するサービスをオンサイトで翌営業日 (注2) に提供し、午前8時～午後5時の無料の電話サポート (注3) が含まれます。グローバル対応 (注2) により、ある国で購入し、制約のない別の国に移動した製品には、元の保証およびサービス提供がすべて引き続き適用されます。24時間365日対応のサービスによって、HPの保証が無効になることはありません。

注1：条件は国ごとに異なる場合があります。特定の制限および除外が適用されます。

注2：オンサイトサービスは、HPとHPの認定サードパーティプロバイダーとの間のサービス契約に従って提供される場合があります。一部の国では利用できません。グローバルサービスの応答時間は、商取引上の合理的なベストエフォートに基づき、国ごとに異なる場合があります。

注3：電話によるテクニカルサポートは、HPが構成し、HP製およびHPが認定したサードパーティ製のハードウェアおよびソフトウェアにのみ適用されます。無料通話および24時間365日対応のサポートサービスは、一部の国では利用できない場合があります。

HP Care Packサービスは、標準保証を超えてサービス契約を拡張します。サービスはハードウェア購入日から開始します。HP製品に適したレベルのサービスを選択するには、次のサイトにある[HP Care Pack Services Lookup Tool]を使用してください：<http://www.hp.com/go/lookuptool/> (英語サイト)。製品ごとの詳しいHP Care Packサービス情報については、次のサイトを参照してください：<http://www.hp.com/hps/carepack/> (英語サイト)。HP Care Packのサービスレベルおよび応答時間は、地域ごとに異なる場合があります。

製品変更通知

- ユーザーが定義したプロファイルに基づき、製品変更通知 (PCN) および技術情報を電子メールでお客様にプロアクティブに通信するためのプログラム。
- PCNは、工場実装されるハードウェアおよびソフトウェア変更を事前に通知して、移行を計画するための時間を提供します。
- 技術情報は、正確で効果的な問題解決を提供して、テクニカルサポートに問い合わせる必要性を大幅に減らします。

Stable & Consistent Offerings

HPでは、HPワークステーションのお客様向けに、ハードウェア、ソフトウェア、ソリューションのインベーションへの取り組みの一つとして、この画期的なプラットフォーム構成の安定性をご紹介させていただきます。「HP Stable & Consistent Offerings」は、すべてのHP Zワークステーションのプラットフォームで使用期限まで機能するように設計およびテストされた一連のハードウェアおよびソフトウェアを慎重に選択し、それらを基盤として構築されています。このセクションでは、これらのコンポーネントとそれに対応するHPワークステーションのプラットフォームの互換性について概説します。

「HP Stable & Consistent Offerings」は、HPワークステーションのすべてのお客様に世界中どこでもご利用いただけ、特別なプログラムや追加のコストも一切必要ありません。HPワークステーションをカスタマイズするときにハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントを選択するだけで、製品のライフサイクルを通じて同じ構成が購入できるように保証されます。

プロセッサ

製品番号	製品
1XM44AA	インテル® Xeon® Gold 6128プロセッサ
1XM49AA	インテル® Xeon® Silver 4114プロセッサ
1XM51AA	インテル® Xeon® Silver 4108プロセッサ

ハードディスクドライブ

製品番号	製品
LQ037AA	1TB SATA 7200 RPM

グラフィックス

製品番号	製品
2TF08AA	AMD Radeon® Pro WX 3100 4GBグラフィックス

メモリ

製品番号	製品
未定	未定
未定	未定
未定	未定
未定	未定
未定	未定
未定	未定
未定	未定
未定	未定
未定	未定
未定	未定
未定	未定

オプティカルおよび リムーバブルストレージ

製品番号	製品
未定	未定
未定	未定